

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

编号：2026-005

长沙景嘉微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	国泰海通、兴业基金、国泰基金、信达澳亚、恒越基金、鑫元基金（排名不分先后）
时间	2026 年 10 月 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁 董事会秘书周振武
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司自成立以来致力于信息探测、信息处理和综合应用，为客户提供高品质、高可靠的产品、解决方案和服务。公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。 公司芯片产品主要为图形处理芯片（GPU）和边端侧 AI SoC 芯片。 公司成功研发了以 JM5400、JM7 系列、JM9 系列和 JM11 系列为代表的一系列 GPU 芯片，支持 Windows、Linux 及国产主流操作系统，可广泛应用于服务器、图形工作站、台式机、笔记本等设备，已在政务、电信、电力、能源、金融、轨交等多领

域实现应用，形成了云桌面、CAD 工业设计软件、BIM 建筑信息模型设计、3D 地理信息渲染、工业数字孪生等场景的完整解决方案。

公司控股子公司诚恒微自主研发的边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列产品采用高集成度的单芯片设计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元，以其 64TOPS@INT8 的峰值算力、低功耗、灵活计算精度、高实时与低延迟等特性，精准地切入了端侧 AI 应用的核心需求，为客户提供了可靠、高效的算力解决方案；主要面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场，可以涵盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。

目前，公司坚定看好高性能 GPU 与边端侧 AI SoC 未来广阔的发展前景，凭借深厚的技术积淀与研发优势，紧扣“十五五”规划，加强研发投入，优化研发资源配置，推动“高性能 GPU+边端侧 AI SoC 芯片”双轮驱动战略，丰富产品矩阵，以构建覆盖“云一边一端”的算力闭环。同时，公司致力于打造安全可控的国产化算力底座，并通过投资等方式深度融合芯片技术与国防、低空经济等应用场景，拓展具身智能及边缘计算等通用市场，形成“芯片一场景一生态”的协同发展模式。

二、座谈交流环节

1、请介绍下公司研发费用的增长情况以及后续投入展望？

2026 年前三季度公司投入研发 44,148.94 万元，持续通过大规模研发投入不断推进技术升级，同时，公司主动引进各领域的高端人才，提升研发效率与创新活力，持续推动芯片迭代优化以及生态体系建设。

从研发投入强度看，公司持续加强研发团队建设，引进了架构设计、后端软件及 SoC 集成等领域的高端人才，并结合内部培养机制，持续推动芯片迭代优化与生态体系建设。高强度研发是公司构建覆盖“云一边一端”的算力闭环必要投入，也为后续

	产品和生态建设提供了有力支撑。 后续投入展望方面，公司将继续保持积极的研发投入基调，投入重点围绕高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目以及边端侧 AI SoC 芯片展开，公司将在高强度投入与经营可持续性之间寻求动态平衡。 2、请问公司 2026 年第三季度内主要开展的工作和取得的结果有哪些？ 一是推进产业生态融合。公司作为 openKylin 社区共建单位，参与 openKylin3.0 版本驱动适配与内核调优；与中博数智签署液冷合作；联合飞腾推出全栈国产 GPU 云桌面方案；JM11 系列完成与中望 CAD、中望 3D 的全功能适配。 二是丰富产品矩阵。JM11 系列在渲染性能、虚拟化能力与操作系统兼容性方面较上一代明显提升，围绕云桌面、工业设计、地理信息等场景形成完整解决方案，并与深信服联合打造信创云桌面方案，亮相 2026 数智创新大会。 三是加快低空安全布局。公司与永州零陵机场签署战略合作协议，低空智能安防系统完成现场试点部署；后续将以民航机场场景为切入点，持续完善低空安全产品体系，推动相关产品与解决方案在更多场景应用。 四是完善长效激励机制。公司同步推出股份回购、限制性股票激励计划及员工持股计划，将核心团队与公司长期发展相绑定。 3、控股子公司诚恒微的边端侧芯片 CH37 系列有什么新进展？另外，未来在端侧领域有什么新方向？ 诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列基于自主研发架构，采用高集成度的单芯片设计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元，可提供 64TOPS@INT8 的峰值
--	---

	计算能力，在确保高性能的同时，将功耗维持在较低水平。在算力达到高水平的时候，功耗得到了稳定控制，实现了出色的能效比。主要面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场，可以涵盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。 目前 CH37 系列产品开始进入小批量交付阶段，例如在 AI 盒子场景中，基于 CH37 系列可在本地对多路视频流进行实时分析、识别与信息提取，支撑实时推理和视频处理类应用。 未来端侧会围绕不同算力档位的芯片布局、成本优化、AI 感知与端侧大模型能力、多模态融合感知等方向做探索和评估，具体包括但不限于提升 VLA 等轻量化模型的本地推理与专用加速能力；相关方向将结合场景需求和研发进展动态调整，不排除后续取舍或变化。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 10 月 28 日